

Presse-Information HEITEC AG
Eckental/Nürnberg, 25. Juli 2020

Von der Idee zum Produkt

Weltweite Erstvorstellung der Embedded Systemplattform HeiSys

Robust und multidimensional skalierbar kann das System als universelles Gateway oder Edge-Computer für schnelle Lösungen, etwa in IoT- oder mobilen Anwendungen, eingesetzt werden

Auf der embedded world 2020 stellte HEITEC erstmals seine neue robuste Embedded Systemplattform HeiSys vor. Die Plattform ist für hohe Skalierbarkeit und größtmögliche Flexibilität ausgelegt und kann als universelles Gateway, Box-PC oder Edge-Computer, insbesondere in IoT-Anwendungen, aber auch in anderen Bereichen eingesetzt werden. HeiSys ist zudem für medizinische, und industrielle Applikationen, den mobilen Einsatz und nach Bahnrichtlinien zertifiziert.

Plug-on-Module erfreuen sich immer größerer Beliebtheit in vielen Märkten, da sich damit selbst Lösungen mit umfassenderem Performance-Anspruch relativ einfach realisieren lassen. HEITEC verbindet mit der neuen Embedded Systemplattform Vorteile verschiedener zukunftsorientierter Plug-on-Module und bietet Kunden eine modulare Basis mit standardisierten Schnittstellen für die rasche und kostengünstige Realisierung ihrer jeweiligen Anwendung.

Schnelle und passgenaue Lösungen durch Plug-on-Module

Durch die Verwendung Standard-basierter Prozessor- und FPGA-Module kann HeiSys sowohl auf die gewünschte Rechenleistung skaliert als auch um die benötigten Kommunikationsschnittstellen erweitert werden. Kunden haben so die Möglichkeit, die Plattform flexibel an die individuelle Anforderung ihrer Zielapplikation anzupassen bzw. Anwendungen mit intensiver Datenverarbeitung schnell, ausfallsicher und ohne großen Aufwand zu realisieren. Ein komplizierter, zeitintensiver Aufbau bzw. die aufwendige Koordinierung verschiedenster Bauteile entfällt.

Je nach Komplexität des Designs und den Anforderungen an Bandbreite, Signalvielfalt, Leistung und Stromverbrauch können entsprechende COM Express Boards gewählt und in Kombination mit SMARC Modul-basierten FPGA-Boards über das entsprechende FPGA-Design eine große Varianz an Schnittstellen abgebildet werden. Zukünftig wird auch der neue COM HPC Standard unterstützt. Die volle Flexibilität hinsichtlich kabelloser Übertragungstechniken wird über m.2 Schnittstellen gewährleistet. Konzipiert ist die Systemplattform für die Nutzung von WLAN, LTE, 5G, UMTS, GSM, LPWA, LoRa, WiFi, Bluetooth, GPS/GLONASS Multiband-Funkmodulen für industrielle Datenkommunikation und den Einsatz im Bahnbetrieb. Durch die Zulassung nach EN50155 – anwendbar auf in Schienenfahrzeugen eingebaute elektronische Betriebsmittel - ist das kompakte System für den mobilen Einsatz als Rolling Stock oder für Wayside Monitoring zertifiziert. Aufgrund des Verzichts auf bewegliche Teile wie Lüfter, wird die Ausfallsicherheit signifikant erhöht und die MTBF deutlich vergrößert. Das System gewährleistet einen Betrieb im erweiterten Temperaturbereich zwischen -40° und +85° C. Eine Zulassung nach EN50155 impliziert ebenfalls die Möglichkeit des Unterfüllens von IC's und Schutzlackierung der Boards. Das Gehäuse kann je nach Kundenwunsch, geforderten Einsatzbedingungen und nötiger Kühlleistung modular erweitert werden.

Weitere Informationen: www.heitec-elektronik.de

Bild: HEITEC auf der embedded world 2020:

Erstmalige Vorstellung der Embedded Systemplattform HeiSys (Quelle HEITEC).



Firmenprofil der HEITEC AG

HEITEC steht für Industriekompetenz in Automatisierung, Digitalisierung und Elektronik und bietet Lösungen, Produkte und Dienstleistungen. Mit technisch hochwertigen, verlässlichen und wirtschaftlichen Systemlösungen unterstützt HEITEC seine über 2.000 Kunden, ihre Produktivität zu steigern und ihre Produkte zu optimieren. Mehr als 1.000 Mitarbeiter an zahlreichen Standorten im In- und Ausland gewährleisten Kundennähe und Branchenkompetenz. Über 60 % sind Hochschulabsolventen oder verfügen über eine Techniker Ausbildung. HEITEC konnte in den letzten Jahren deutlich über 10 % wachsen und hat somit den Umsatz in fünf Jahren verdoppelt.

www.heitec.de

HEITEC AG

Romy Hüls

Dr.-Otto-Leich-Str. 16

90542 Eckental

Tel: +49 (0)9126 2934-142

elektronik@heitec.de

www.heitec-elektronik.de

MIKE ROTH – Concept.

Artwork. Publishing

Sylvia König - PR

Rosenheimer Str. 32

83083 Riedering

Tel: +49 (0)89 991 608 61

skoenig-pr@mikeroth.de

www.mikeroth.de